

## 台灣半導體科技教育協會第一期課程

第一週	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	

## 台灣半導體科技教育協會第一期課程

第二週	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	考試	
20:55~ 21:40	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	考試	

## 台灣半導體科技教育協會第一期課程

第三週	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	

## 台灣半導體科技教育協會第一期課程

第四週	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	3.4 SPC 統計制程式控制	3.5 FMEA 的觀念與應 用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	休息
19:15~ 20:00	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	3.4 SPC 統計制程式控制	3.5 FMEA 的觀念與應 用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	
20:10~ 20:55	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	業師輔導 互動交流	4.1 漫遊 IC 封裝世界 -入門級	4.3 記憶體測試	考試	
20:55~ 21:40	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	業師輔導 互動交流	4.1 漫遊 IC 封裝世界 -入門級	4.3 記憶體測試	考試	

## 台灣半導體科技教育協會第一期課程/第二期課程

TSTEA 台灣半導體科技教育協會秘書長 張卓浩 (籌備處)    Taiwan Semiconductor Technology Education Association (Preparatory Office)  
 E-mail: a0535168@gmail.com    Mobile:+886-918925236    ID: johnson0535168

第一週	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	結業典禮	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	結業典禮	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	

## 台灣半導體科技教育協會第二期課程

第二週	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	考試	
20:55~ 21:40	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	考試	

## 台灣半導體科技教育協會第二期課程

第三週	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	

## 台灣半導體科技教育協會第二期課程

第四週	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術與應用	3.3 PCB 制程簡介	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝測試設備簡介	休息
19:15~ 20:00	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術與應用	3.3 PCB 制程簡介	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝測試設備簡介	
20:10~ 20:55	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	業師輔導 互動交流	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界-入門級	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	業師輔導 互動交流	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界-入門級	業師輔導 互動交流	

## 台灣半導體科技教育協會第二期課程/第三期課程

第一週	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.1 全球半導體產業概況 暨就業前景	1.3 積體電路設計	休息
19:15~ 20:00	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.1 全球半導體產業概況 暨就業前景	1.3 積體電路設計	
20:10~ 20:55	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	
20:55~ 21:40	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	

## 台灣半導體科技教育協會第三期課程

第二週	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	休息
19:15~ 20:00	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	
20:10~ 20:55	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	
20:55~ 21:40	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	

## 台灣半導體科技教育協會第三期課程

第三週	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~19:15	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	業師輔導 互動交流	休息
19:15~20:00	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	業師輔導 互動交流	
20:10~20:55	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	考試	
20:55~21:40	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	考試	

## 台灣半導體科技教育協會第三期課程

第四週	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	休息
19:15~ 20:00	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	
20:10~ 20:55	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	
20:55~ 21:40	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	

## 台灣半導體科技教育協會第三期課程

第五週	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界- 入門級	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	中秋節
19:15~ 20:00	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界- 入門級	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	
20:10~ 20:55	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	
20:55~ 21:40	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	